

2019年3月期 第3四半期（2018年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2019年1月31日

内容：

- 第3四半期 連結決算の概要
- 事業環境および業績予想

経理部長

代表取締役社長・CEO

笹川 謙

河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第3四半期 連結決算の概要

2019年1月31日

笹川 謙
経理部長



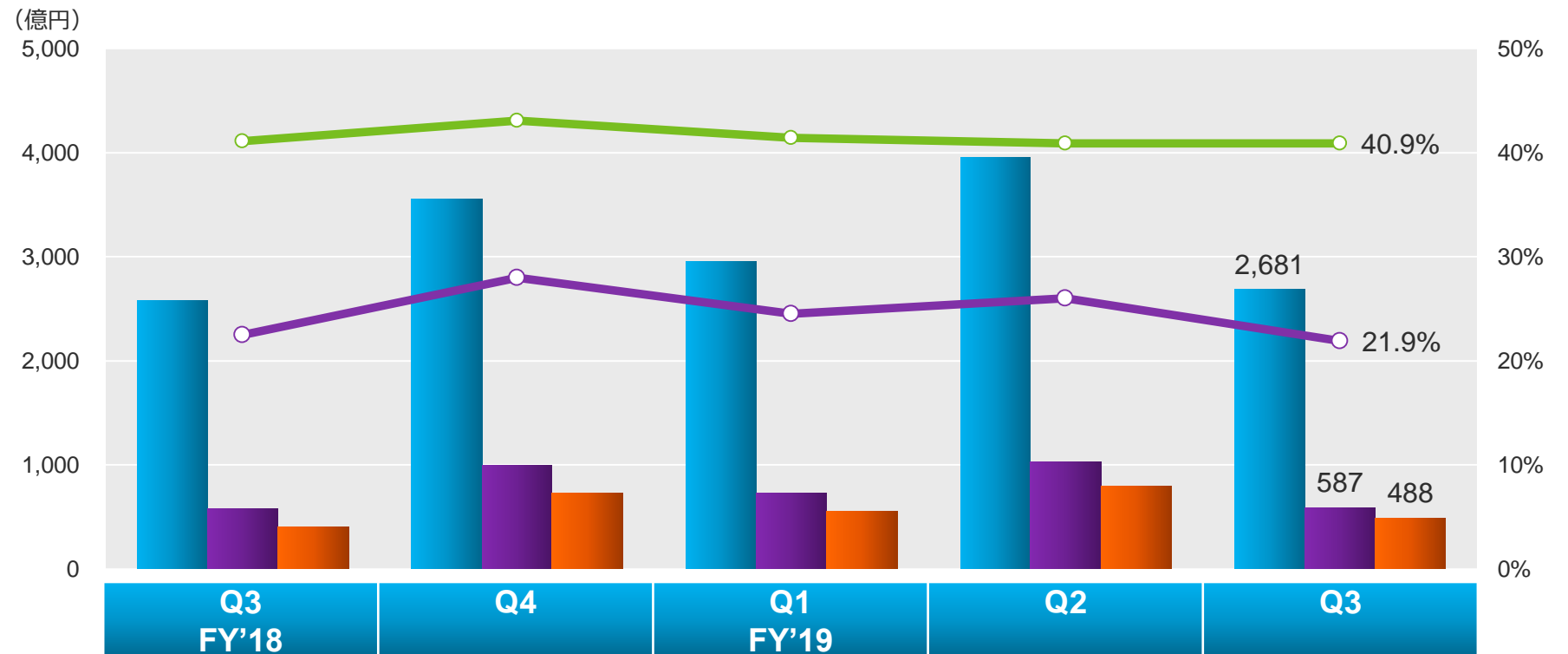
損益状況

(億円)

	FY2018		FY2019			対FY2019 Q2 増減率
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	2,577	3,559	2,955	3,954	2,681	-32.2%
SPE	2,414	3,260	2,804	3,580	2,395	-33.1%
FPD	162	297	151	373	285	-23.4%
売上総利益	1,060	1,535	1,224	1,616	1,097	-32.1%
下段：売上総利益率	41.1%	43.1%	41.4%	40.9%	40.9%	+0.0pts
販管費	479	537	500	586	510	-12.9%
営業利益	580	997	724	1,030	587	-43.0%
下段：営業利益率	22.5%	28.0%	24.5%	26.0%	21.9%	-4.1pts
税金等調整前当期純利益	573	956	752	1,058	605	-42.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	407	729	557	795	488	-38.6%
研究開発費	239	270	261	312	265	-14.9%
設備投資額	137	120	96	132	118	-10.7%
減価償却費	55	60	50	56	62	+11.1%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

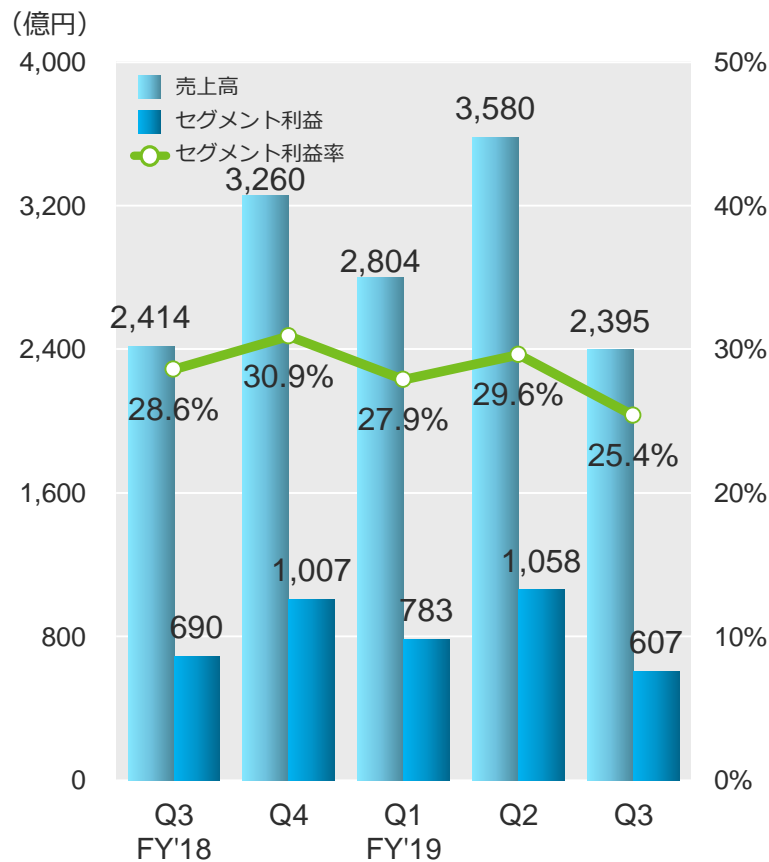
損益状況



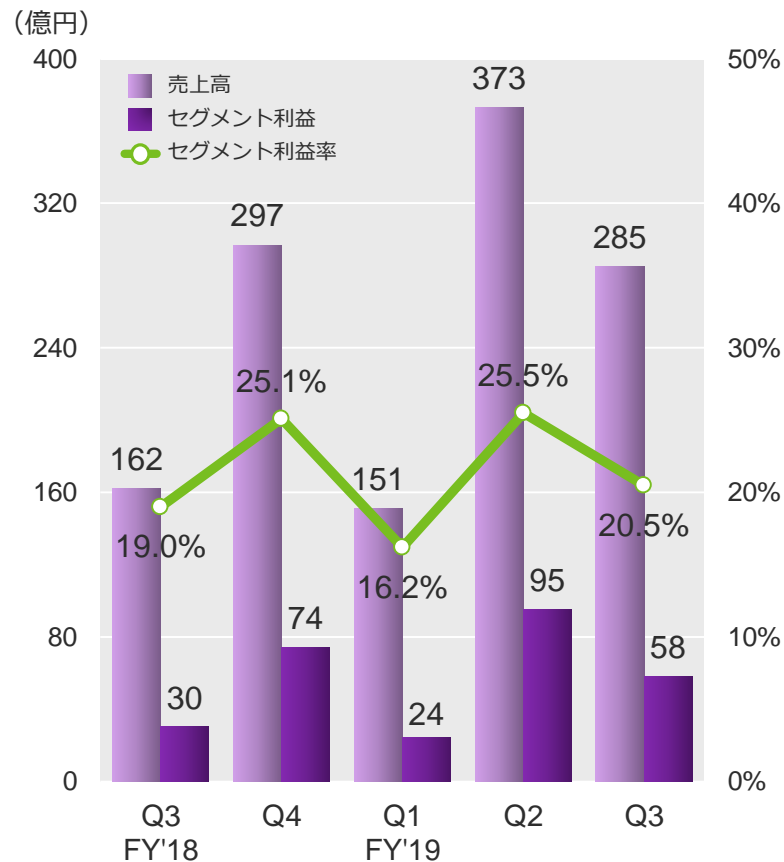
■ 売上高	2,577	3,559	2,955	3,954	2,681
■ 営業利益	580	997	724	1,030	587
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	407	729	557	795	488
○ 売上総利益率	41.1%	43.1%	41.4%	40.9%	40.9%
○ 営業利益率	22.5%	28.0%	24.5%	26.0%	21.9%

セグメント情報

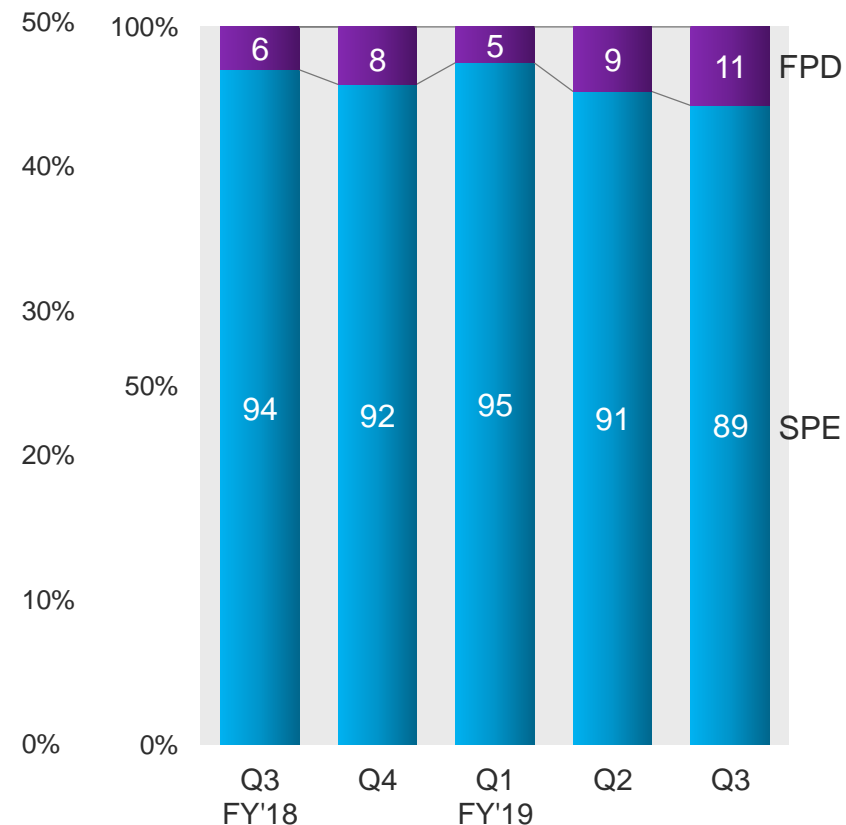
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

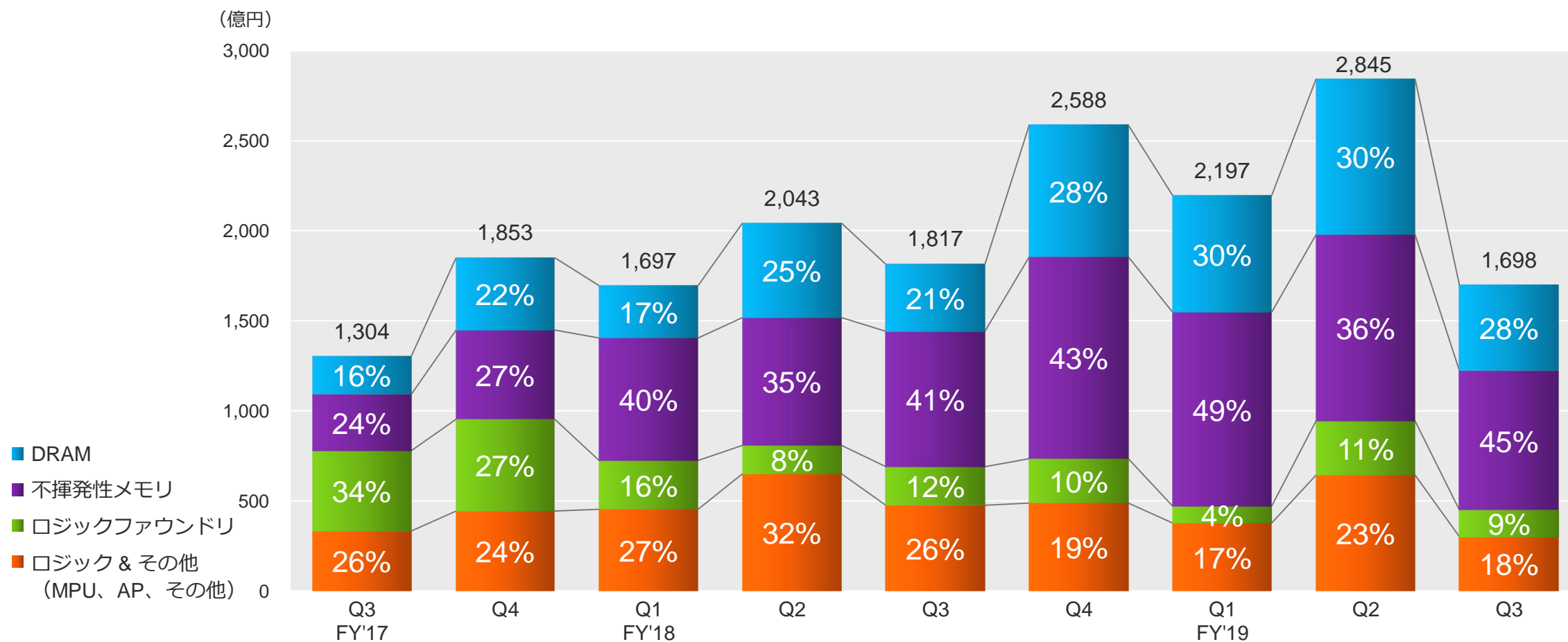


売上構成比率

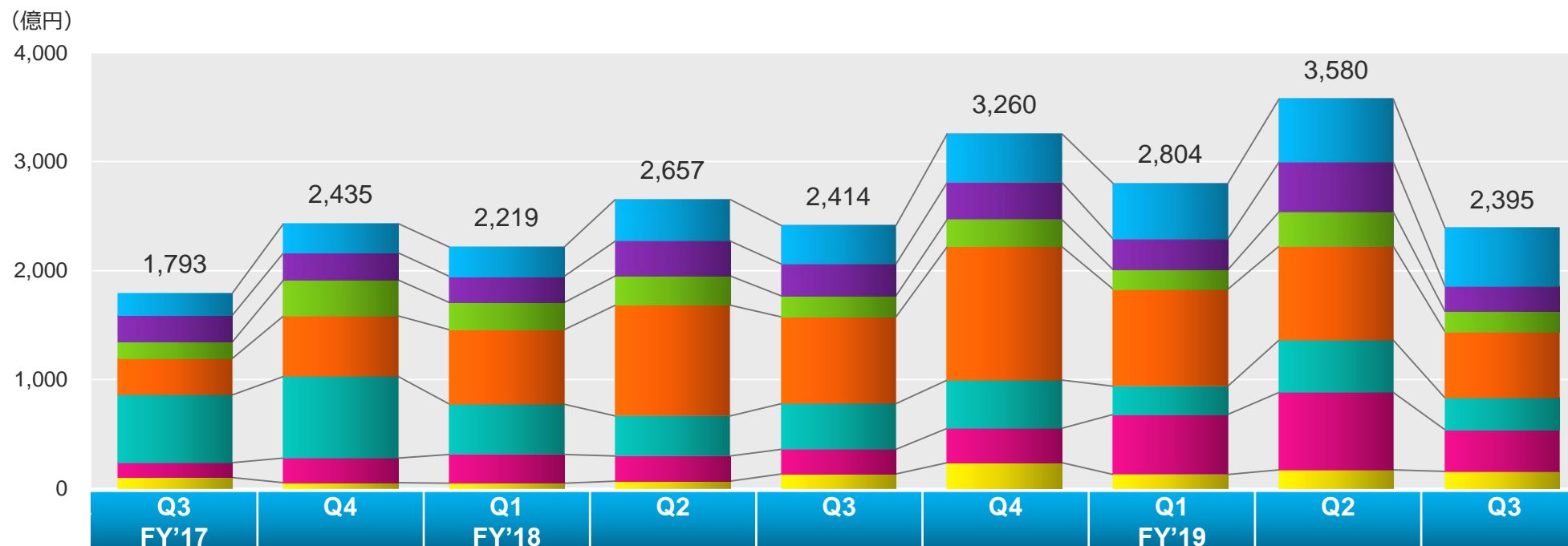


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



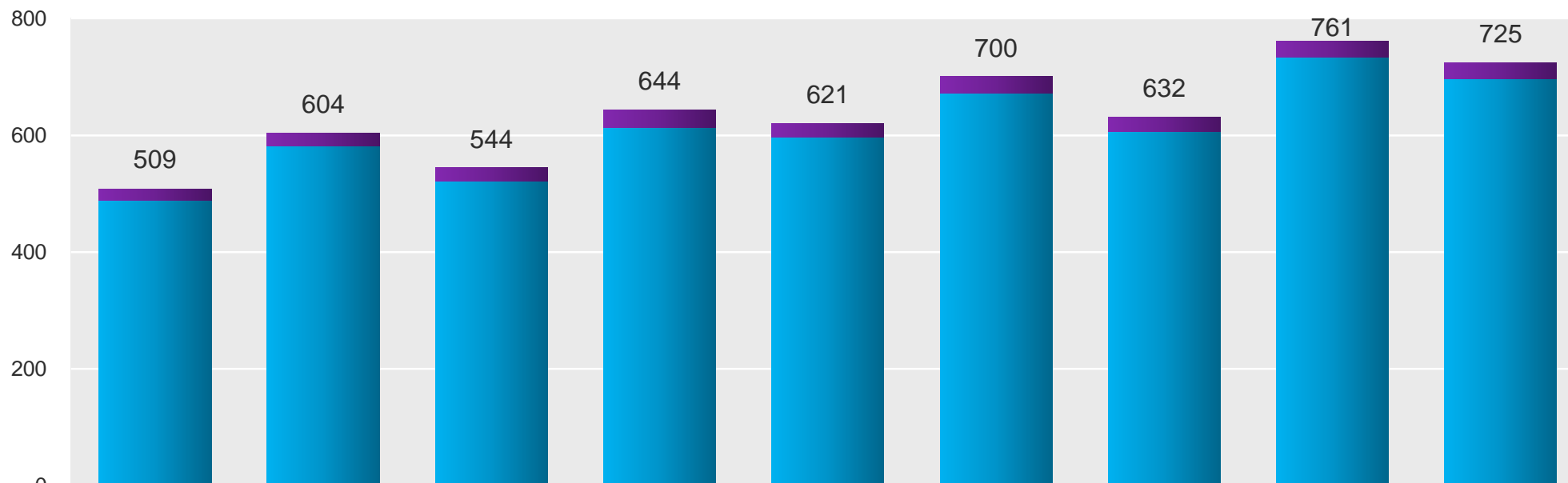
SPE部門 地域別売上高



■ 日本	203	266	267	384	351	451	511	580	540
■ 北米	246	254	240	320	291	339	284	459	227
■ 欧州	150	329	253	269	196	250	177	313	186
■ 韓国	333	555	683	1,017	794	1,223	889	865	609
■ 台湾	623	747	458	366	421	443	263	480	293
■ 中国	137	227	267	230	226	318	549	713	380
■ 東南アジア・他	98	53	46	67	132	234	127	168	156

フィールドソリューション売上高

(億円)

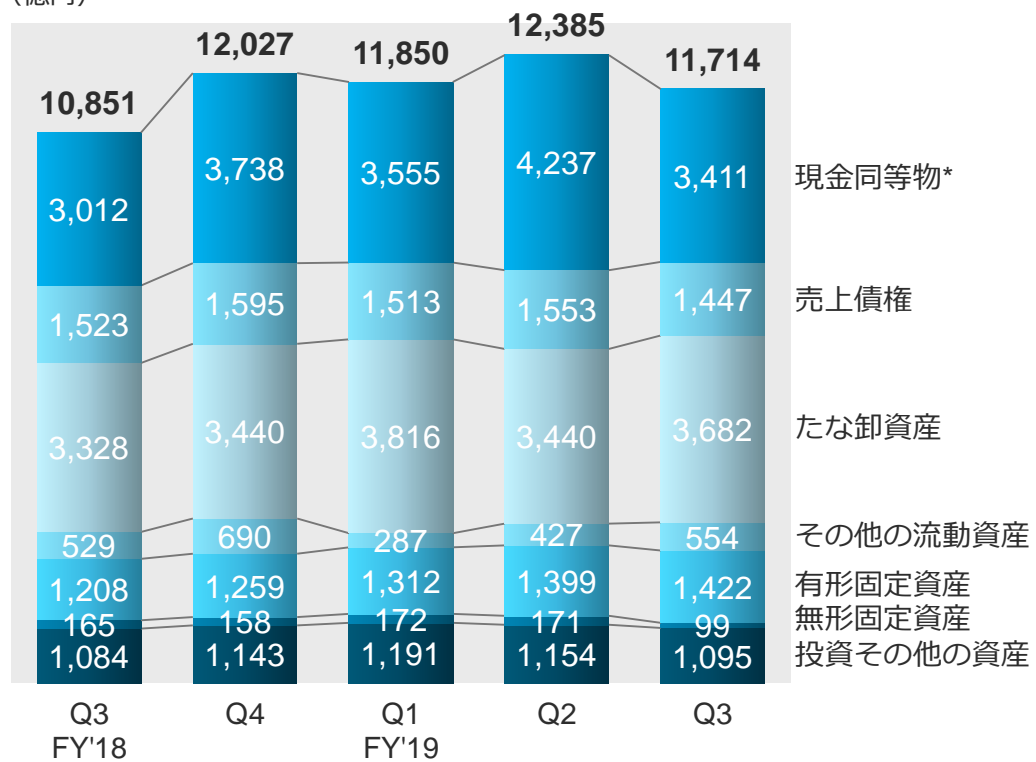


	Q3 FY'17	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3
SPE売上高	488	581	522	614	597	672	606	734	696
FPD売上高	20	22	22	29	24	28	25	27	28

貸借対照表

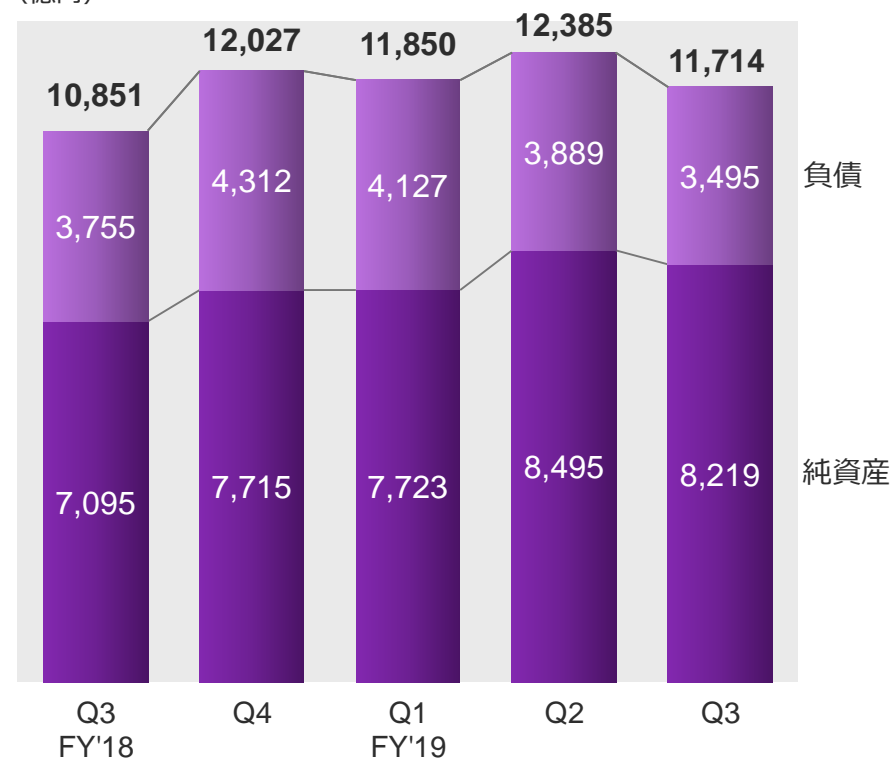
資産

(億円)



負債・純資産

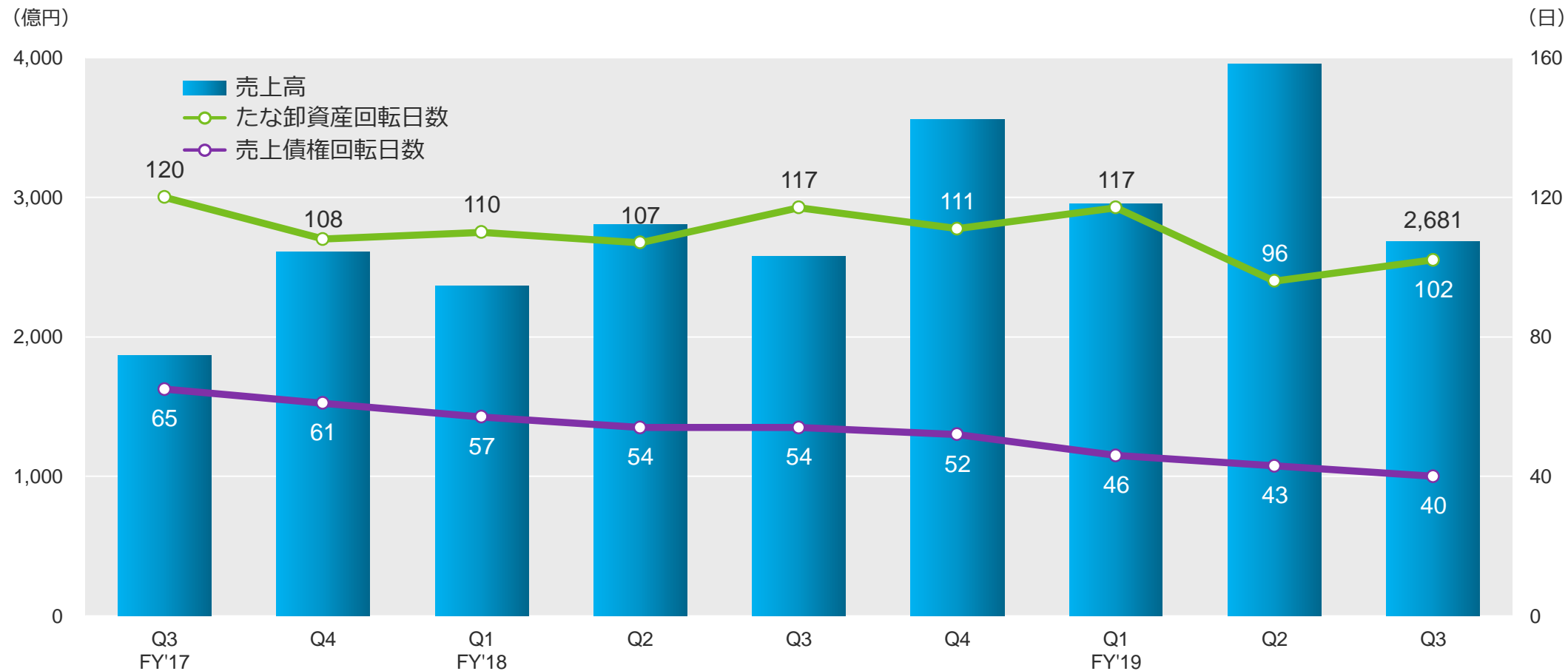
(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等をFY2019 Q1会計期間の期首から適用しており、FY2018の実績については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しています。

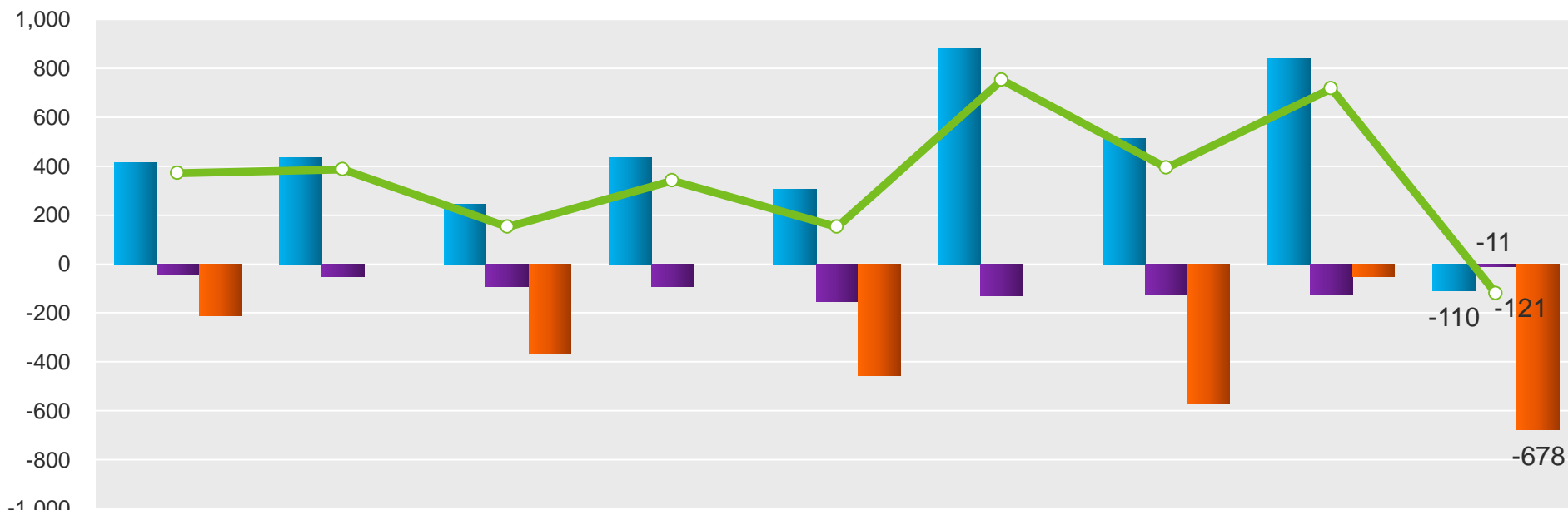
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	Q3 FY'17	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3
■ 営業キャッシュ・フロー	413	436	244	434	304	881	514	840	-110
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-41	-49	-93	-94	-152	-128	-121	-122	-11
■ 財務キャッシュ・フロー	-210	-0	-368	-0	-457	-0	-569	-50	-678
○ フリーキャッシュ・フロー*2	371	387	151	340	151	753	393	717	-121
手元資金残高*3	2,772	3,153	2,946	3,299	3,012	3,738	3,555	4,237	3,411

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

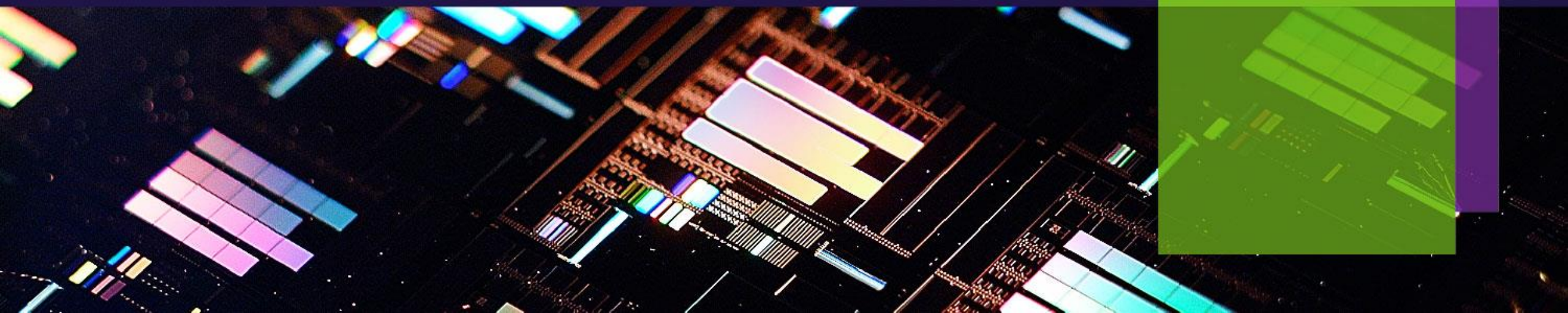
*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

事業環境および業績予想

2019年1月31日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2019年1月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2019の投資は、ロジック/ファウンドリ向けが回復も、半導体メモリ需要の軟化と米中貿易摩擦等の影響で、前年比15~20%程度の減少を想定。年前半は投資が抑制されるも、年後半からの投資回復を期待

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2019の装置需要は、前年比30%程度の減少を想定。モバイル用途のOLEDパネル向け設備投資が軟調、大型パネル向けも投資調整。年後半からの回復を期待

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2019 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- ロジック/ファウンドリ：前年比25%程度増加
 - 市場環境：世代移行による設備投資増加。10nm以細の世代向けが5割を占める
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大
- DRAM：前年比30%程度減少
 - 市場環境：設備投資の6割以上が1Y/1Znm世代向け
 - 事業機会：最先端世代における一括パターンニング、配線工程での差別化
- 不揮発性メモリ：前年比50%程度減少
 - 市場環境：歩留向上にともなう生産能力増強投資の調整
9X/12X層数の世代向けが全体投資の8割以上
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

期待される年後半からの投資回復に備える

FY2019 SPE事業の進捗 (Q1~Q3)

- 戦略製品の売上が拡大し、CY2018のシェア目標に対して順調に進捗。
注力分野（エッチング、成膜、洗浄）における次世代のPOR*1の獲得も進む
- プロセスインテグレーションの提案がPOR拡大に貢献
 - クリティカルモジュールにおいて、エッチング、洗浄、成膜の相互最適化によりデバイス性能と歩留を向上
- IoTアプリケーションの拡大とインストールベース*2の増加により、FS事業は収益拡大
- 宮城工場（エッチング装置）の拡張
 - 新開発棟の竣工（10月）
 - 新生産ラインの稼働（11月）

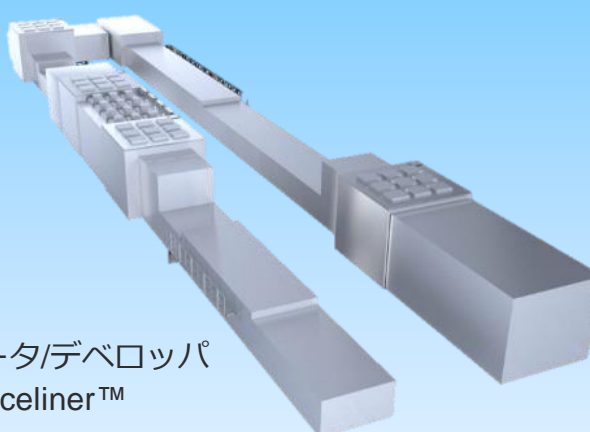


東京エレクトロン宮城

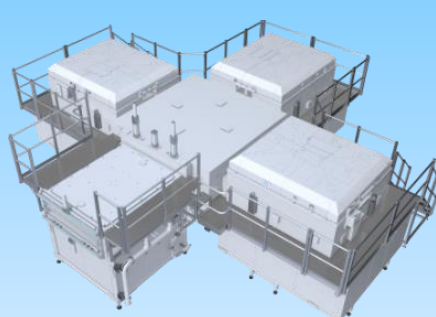
事業戦略は計画通り進捗、次世代向け技術で収益拡大

FY2019 FPD事業の進捗 (Q1~Q3)


- 第10.5世代向け装置の拡販。売上・利益率向上に貢献
- 新製品を販売開始し、受注済み
 - 高精細FPD向け第10.5世代プラズマエッチング装置 Impressio™ 3300 PICP*™
 - 有機ELディスプレイ向け第4.5世代インクジェット描画装置 Elius™ 1000



FPDコータ/デベロッパ
Excliner™



FPDプラズマ
エッチング/アッシング装置
Impressio™



有機ELディスプレイ製造用
インクジェット描画装置 Elius™

過去最高の通期売上と計画通りの利益率向上を見込む

FY2019 業績予想

FY2019 業績予想 (2018/10/31発表から変更なし)

(億円)

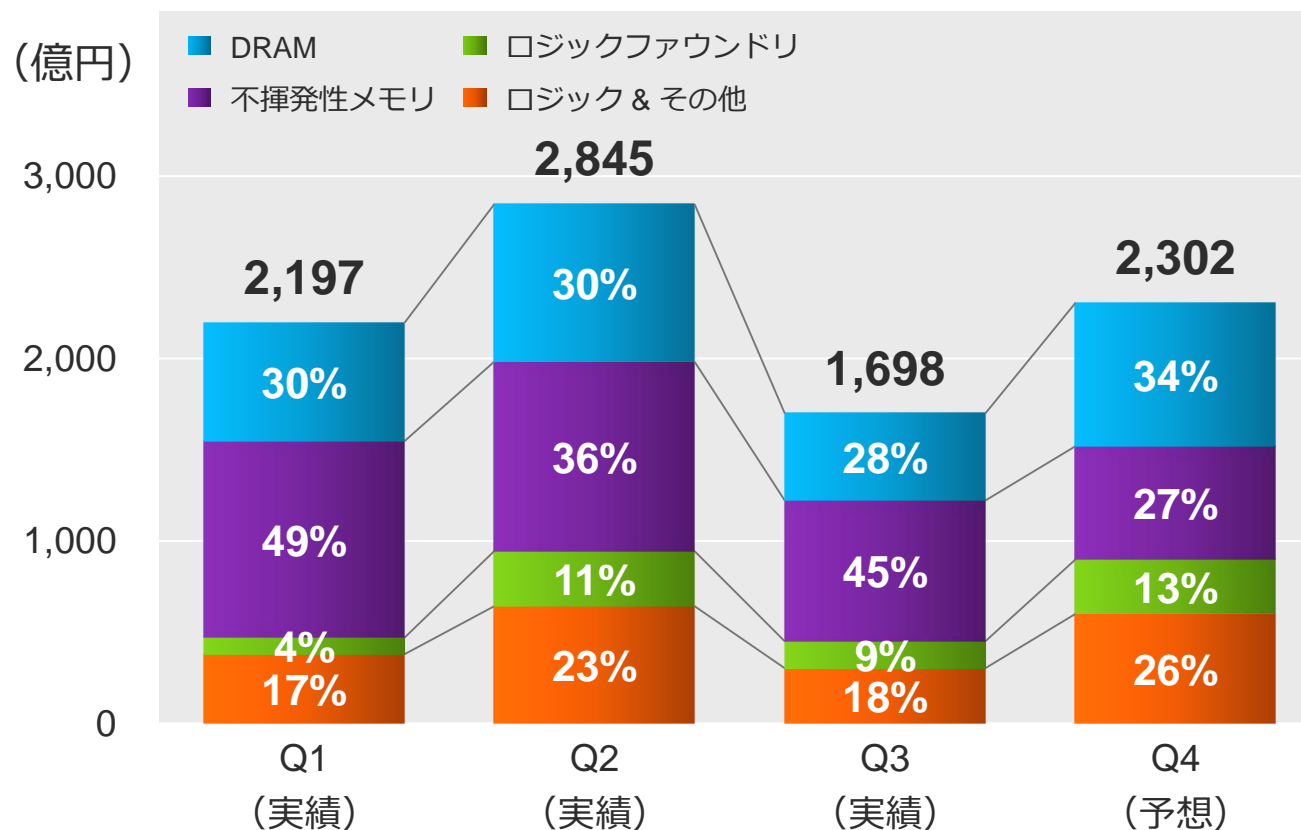
	FY2018 (実績)	FY2019 (予想)				通期 対前年増減
		H1	H2	通期	通期 対前年増減	
		実績	予想	予想		
売上高	11,307	6,910	5,889	12,800	+13.2%	
SPE	10,552	6,384	5,313	11,698	+10.9%	
FPD	750	524	575	1,100	+46.5%	
売上総利益 下段：売上総利益率	4,750 42.0%	2,841 41.1%	2,438 41.4%	5,280 41.3%	+529 -0.7pts	
販管費	1,938	1,086	1,103	2,190	+251	
営業利益 下段：営業利益率	2,811 24.9%	1,754 25.4%	1,335 22.7%	3,090 24.1%	+278 -0.8pts	
税前利益	2,752	1,811	1,338	3,150	+397	
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,043	1,352	1,017	2,370	+326	
1株当たり当期純利益 (円)	1,245.48	824.70	-	1,445.13	+199.65	

市場拡大とシェア向上により、3期連続の過去最高益*を見込む

* 売上総利益・親会社株主に帰属する当期純利益
SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置

FY2019 SPE部門 新規装置売上予想

FY2019 アプリケーション別売上構成比

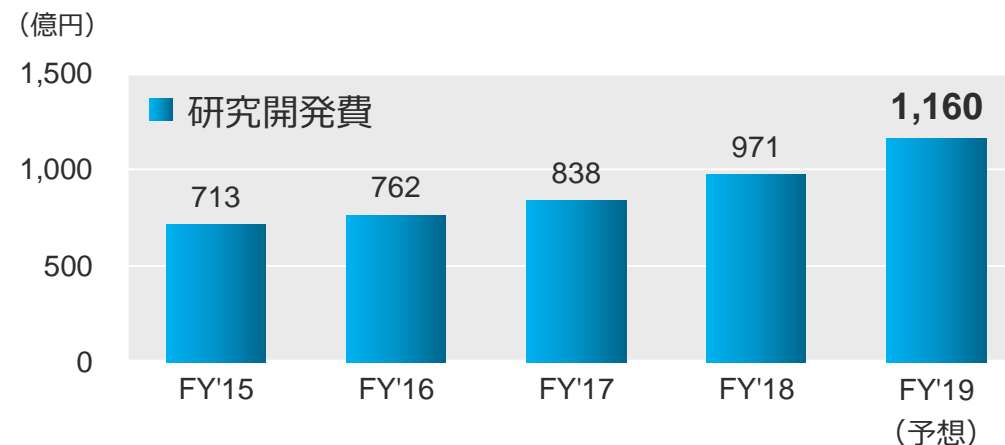


下期予想に沿って順調に進捗

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。また、Q4予想の2,302億円は2018年10月31日発表の下期予想値からQ3実績を引いた値です。

FY2019 研究開発費・設備投資計画 (2018/10/31発表から変更なし)

- 開発費 1,160億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 510億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 260億円



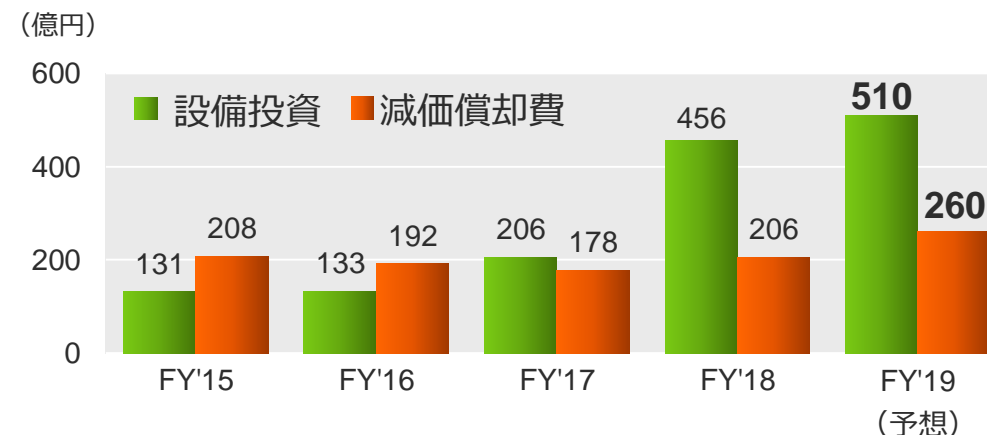
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士川町：建設費約130億円
(2019年2月着工、2020年4月竣工予定)

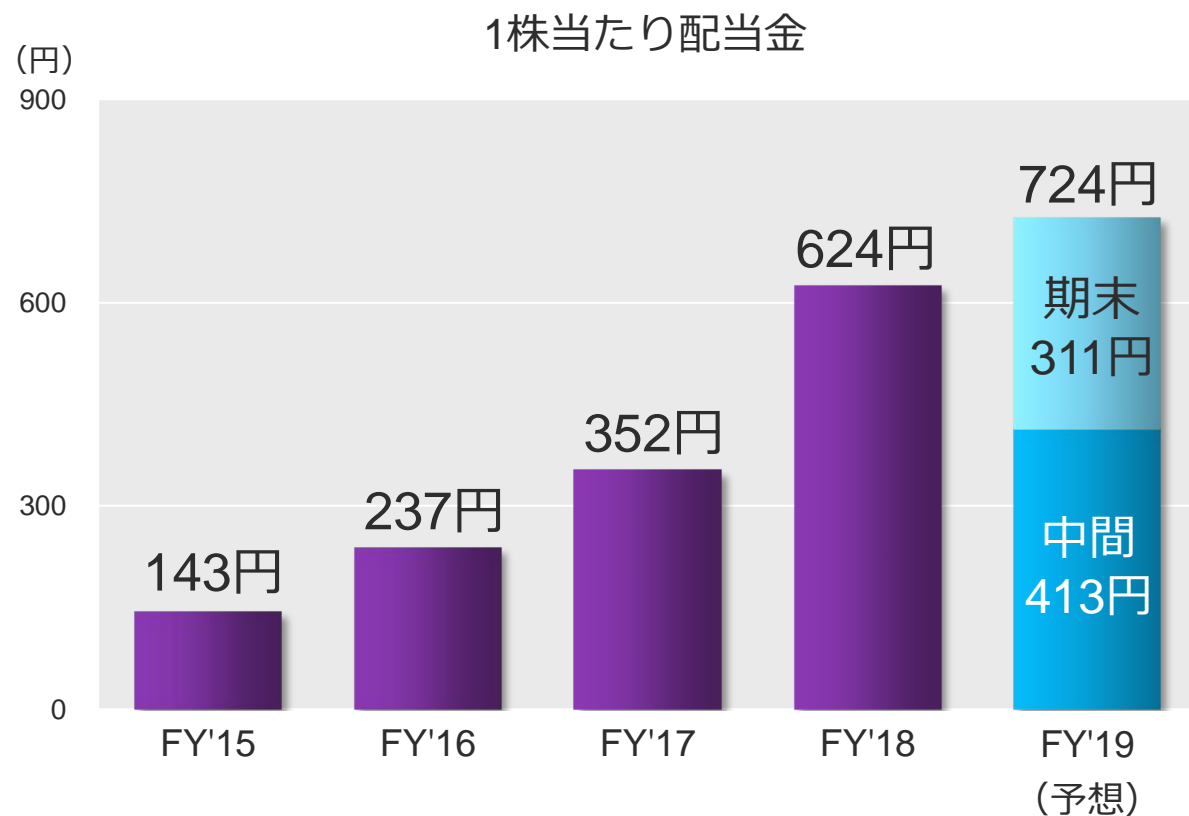


岩手県奥州市：建設費約130億円
(2018年10月着工、2019年9月竣工予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2019 配当予想 (2018/10/31発表から変更なし)



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比16%増加の724円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON